



上海证券
SHANGHAI SECURITIES

晶圆代工产能利用率逐季攀升，AMD 获得玻璃基板技术专利

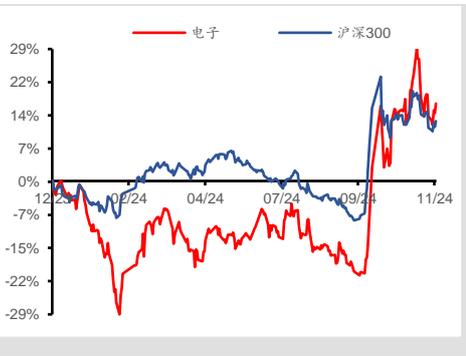
——电子行业周报（2024.11.25-2024.11.29）

增持（维持）

行业： 电子
日期： 2024年12月02日

分析师： 王红兵
SAC 编号： S0870523060002

最近一年行业指数与沪深 300 比较



相关报告：

《全球半导体市场蓬勃发展，三星加码先进封装》

——2024 年 11 月 25 日

《周观点：AWS 营业利润率持续增长，苹果 AI 落地加速》

——2024 年 11 月 20 日

《大厂接连推出智能眼镜，光刻机龙头 ASML 积极展望芯片未来》

——2024 年 11 月 18 日

核心观点

市场行情回顾

过去一周（11.25-11.29），SW 电子指数上涨 2.38%，板块整体跑赢沪深 300 指数 1.06 个百分点，从六大子板块来看，半导体、电子化学品 II、元件、消费电子、光学光电子、其他电子 II 涨跌幅分别为 3.25%、2.75%、2.34%、1.55%、0.82%、0.60%。

核心观点

2024 年四季度全球主要晶圆厂平均产能利用率约 81%，同比增 8 个百分点。根据群智咨询报道，得益于智能手机、通信、汽车、物联网等应用的需求回升，晶圆代工产能利用率从 2024 年一季度起逐步恢复，2024Q4 全球主要晶圆厂平均产能利用率同比增加 8 个百分点。分制程来看，成熟制程的降价趋势在 2024 年初仍在持续；与此形成鲜明对比的是，随着人工智能的快速发展，对 AI 芯片、高性能存储的需求不断攀升，先进制程产能利用率饱满。然而，随着时间步入 24Q3，晶圆代工市场格局发生转变，得益于智能手机、通信、汽车、物联网等应用的需求回升，成熟制程整体产能利用率正显著回升；随着苹果、联发科和高通等大客户对 3 纳米制程的需求旺盛，英伟达、AMD 等高性能计算领域客户的持续拉货，先进制程需求持续攀高。展望未来，群智咨询预计 2025 年 28/40nm HV 制程由于中国大陆晶圆厂与台湾地区晶圆厂争夺订单，晶圆价格将持续稳定微降；2025 年 55HV 新增产能将继续释放，预计该制程晶圆价格将继续下调；由于 90HV 上半年新增产能较少，且受益于 8 英寸转 12 英寸趋势，预计该制程价格在 2025 年上半年总体稳定；8 英寸晶圆价格已降至低位，晶圆厂普遍已停止继续降价的动作。

玻璃基板又出新进展，其有望成为下一代先进封装基板材料。据芯智讯援引 Tom's hardware 报道，近日 AMD 已获得一项涵盖玻璃芯基板技术的专利（专利号“12080632”），这也反应了 AMD 正在积极的研究玻璃芯基板技术，为其在 2026 年采用玻璃基板为其芯片打造超高性能系统级封装（SiP）的计划提供助力，同时也避免相关专利风险。AMD 的专利明确指出，玻璃基板在热管理、机械强度和信号传输方面具有显著优势。AMD 的专利还描述了一种使用铜基键合来粘合多个玻璃基板的方法，这种方法提高了连接的可靠性，并消除了对底部填充材料的需求，适合于堆叠多个基板。不仅是 AMD，其他行业巨头如英特尔和三星也在积极布局玻璃基板，2023 年 9 月，英特尔即宣布推出业界首款用于下一代先进封装的玻璃基板，计划于 2026-2030 年量产；据财联社报道，在 1 月的 CES 2024 上三星电机已提出，今年将建立一条玻璃基板原型生产线，目标是 2025 年生产原型，2026 年实现量产。

投资建议

维持电子行业“增持”评级，我们认为电子半导体 2024 年下半年或正在迎来全面复苏，同时，产业竞争格局有望加速出清修复，产业盈利周期和相关公司利润有望持续复苏。我们当前建议关注：半导体设计领域部分超跌且具备真实业绩和较低 PE/PEG 的个股，AIOT SoC 芯片建议关注中科蓝讯和炬芯科技；模拟芯片建议关注美芯晟和南芯科技；建议关注驱动芯片领域峰昭科技和新相微；半导体设备材料建议关注华海诚科和昌红科技；折叠机产业链建议关注统联精密及金太阳；建议关注军工电子紫光国微和复旦微电；建议关注华为供货商汇创达。

风险提示

中美贸易摩擦加剧、终端需求不及预期、国产替代不及预期。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询资格或相当的专业胜任能力，以勤勉尽责的职业态度，独立、客观地出具本报告，并保证报告采用的信息均来自合规渠道，力求清晰、准确地反映作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响。此外，作者薪酬的任何部分不与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。

公司业务资格说明

本公司具备证券投资咨询业务资格。

投资评级体系与评级定义

| | |
|--|---|
| 股票投资评级： | 分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据公司基本面及（或）估值预期以报告日起 6 个月内公司股价相对于同期市场基准指数表现的看法。 |
| 买入 | 股价表现将强于基准指数 20%以上 |
| 增持 | 股价表现将强于基准指数 5-20% |
| 中性 | 股价表现将介于基准指数±5%之间 |
| 减持 | 股价表现将弱于基准指数 5%以上 |
| 无评级 | 由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级 |
| 行业投资评级： | 分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据行业历史基本面及（或）估值对所研究行业以报告日起 12 个月内的基本面和行业指数相对于同期市场基准指数表现的看法。 |
| 增持 | 行业基本面看好，相对表现优于同期基准指数 |
| 中性 | 行业基本面稳定，相对表现与同期基准指数持平 |
| 减持 | 行业基本面看淡，相对表现弱于同期基准指数 |
| 相关证券市场基准指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；港股市场以恒生指数为基准；美股市场以标普 500 或纳斯达克综合指数为基准。 | |

投资评级说明：

不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准，投资者应区分不同机构在相同评级名称下的定义差异。本评级体系采用的是相对评级体系。投资者买卖证券的决定取决于个人的实际情况。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，投资者不应以分析师的投资评级取代个人的分析与判断。

免责声明

本报告仅供上海证券有限责任公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告版权归本公司所有，本公司对本报告保留一切权利。未经书面授权，任何机构和个人均不得对本报告进行任何形式的发布、复制、引用或转载。如经过本公司同意引用、刊发的，须注明出处为上海证券有限责任公司研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

在法律许可的情况下，本公司或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券或期权并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供多种金融服务。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见和推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值或投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见或推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中的内容和意见仅供参考，并不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负责，投资者据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或关联机构无关。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素，也不应当认为本报告可以取代自己的判断。